

**JSAT 研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会 第5回研究会
JSEM ワイドギャップ半導体デバイスに関わる超精密加工プロセス研究分科会 第11回講演会
合同研究会【ダイヤモンド基板・工具等が生み出す新展開】開催ご案内**

2015年2月、(公社)砥粒加工学会に「研磨の基礎科学とイノベーション化専門委員会」が設立されました。本専門委員会では、「温故知新」の名言に倣い、研磨の歴史・ノウハウ・技術伝承の在り方を探り、そこから次代に向けた課題の明確化とその解決手法開発に取り組むことを目指します。第5回研究会を【ダイヤモンド基板・工具等が生み出す新展開】と題して「ワイドギャップ半導体デバイスに関わる超精密加工プロセス研究分科会」との合同で開催いたします。多数の皆様のご参加をお待ちしています。



略称:KENMA 研究会

日 時: 2016年7月20日(水) 13:00~18:00

(研究会…13:00~17:00, 情報交換会…17:00~18:00)

開催場所: 金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院(愛宕東洋ビル 11F→13F)

【「虎ノ門ヒルズ」の隣のビルです】

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル 11F&12F&13F

(TEL: 03-5777-2227)

http://www.kanazawa-it.ac.jp/about_kit/access.html#anchor06 (アクセスマップ)

東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩8分

都営地下鉄三田線 御成門駅 徒歩8分 JR山手線 新橋駅 徒歩15分

内 容:

「テーマ:ダイヤモンド基板・工具等が生み出す新展開」

13:00~13:10 開会挨拶

KENMA 研究会委員長 畠田道雄(金沢工業大学)

13:10~17:00 話題提供

<技術講演>

1) 13:10~13:45 ダイヤモンドを作り出し磨きあげる～単結晶基板の成長技術と加工技術～

並木精密宝石株式会社 NJC 技術研究所 所長 會田英雄 氏

2) 13:45~14:20 天然ダイヤモンドと人工ダイヤモンド

トーメイダイヤ株式会社 工場次長 安藤 豊 氏

3) 14:20~14:55 トライザクトテクノロジーによる研磨加工技術

スリーエムジャパン株式会社 コーポレートプロダクトプラットフォーム技術部
スペシャリスト 則本雅史 氏

14:55~15:15 休憩

4) 15:15~15:50 固定砥粒研磨によるPCDおよびCVDダイヤモンドの鏡面加工

京都工芸繊維大学 機械工学系 助教 山口桂司 氏

<特別講演>

5) 15:50~16:45 SiCに関わる研究からダイヤモンドウェハのあるべき姿について考える

名古屋工業大学 副学長 江龍 修 氏

16:45~16:50 閉会の挨拶

ワイドギャップ半導体研究会委員長 只友一行(山口大学)

17:00~18:00 情報交換会(軽食を準備します)

参加費: 6,000円(情報交換会・ノンアルコール形式を含む)。当日徴収致します。会場は金沢工業大学 KIT 虎ノ門大学院の会議室です。

※情報交換会終了後には場所を移し「拡大技術交流会(会費:4,000円)」を開催します。※

参加申込締切: 平成28年6月29日(水)

参加申込先並びに問合先: 金沢工業大学 工学部 機械工学科 畠田道雄

TEL: 076-248-1100 FAX: 076-274-7072 E-mail: uneda@neptune.kanazawa-it.ac.jp

※出来る限りメールでお申し込みください※

KENMA 研究会・ワイドギャップ半導体研究会「合同研究会」 参加申込書

氏名			
勤務先・所属			
参 加 内 容 (参加されるものに○を付けて下さい)		研究会(情報交換会含む)	拡大技術交流会(会費:4,000円)
連絡先	住所		
	TEL		FAX
	E-mail		